

SFENG 1984 ()

SF-P111-E

技术规格

PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.90mm(.0748 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 1.35mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
Full travel 行程	6.3(.2481 ")
Spring force 弹簧压力	120g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Phosphor bronze, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	3A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated



□□□□



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



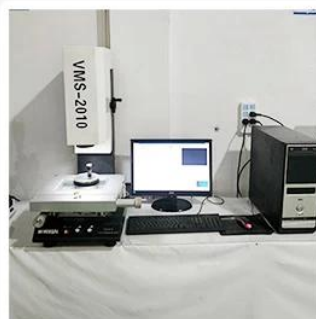
5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 請提供公司簡介

A1: 本公司是一家專業從事各類電子產品研發、生產及銷售的公司，擁有先進的生產設備和技術團隊，致力於為客戶提供優質的電子產品和完善的服務。

Q2. 請提供公司主要產品及服務範圍

A2: 本公司主要產品包括各類電子產品，如手機、平板電腦、筆記本電腦等。服務範圍涵蓋產品研發、生產、銷售及售後服務，並提供專業的技術支持和培訓。

Q3. 請提供公司主要客戶及合作夥伴

A3: 本公司主要客戶包括各大電子產品製造商、零售商及代理商。合作夥伴包括各大電子產品供應商、物流公司及服務商。

Q4. 請提供公司主要市場及銷售渠道

A4: 本公司主要市場包括中國大陸、東南亞、歐洲及北美洲。銷售渠道包括各大電子產品經銷商、代理商及直接銷售。

Q5. 請提供公司主要競爭對手

A5: 本公司主要競爭對手包括各大電子產品製造商、零售商及代理商，如蘋果、三星、華為等。

Q6. 請提供公司主要優勢及競爭力

A6: 本公司主要優勢包括先進的生產設備、優秀的技術團隊、完善的服務體系及專業的技術支持。

Q7. OEM與ODM有何區別？

A7: OEM（Original Equipment Manufacturer）是指代工廠，負責生產客戶提供的設計和規格。ODM（Original Design Manufacturer）是指設計和生產一體，負責客戶提供的需求和規格。

Q8. 請提供公司主要產品及服務範圍

A8: T/T（電匯）、L/C（信用狀）、MOQ（最小訂貨量）

請提供公司主要產品及服務範圍

請提供公司主要產品及服務範圍

請提供公司主要產品及服務範圍



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe









000000



CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

